

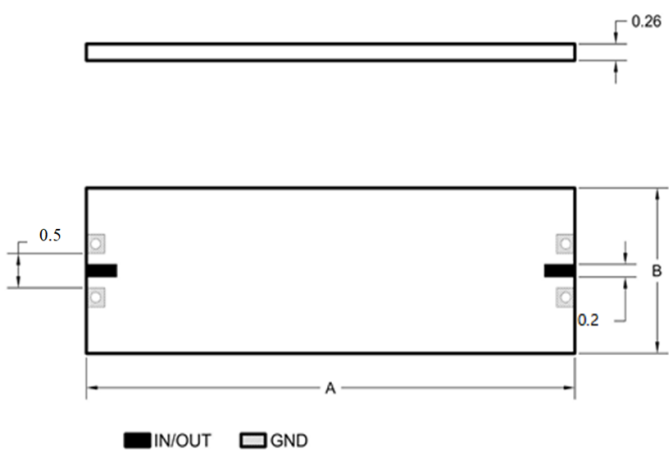
### 技术指标（常温+25℃）

| 序号   | 项目         | 技术指标                                                         |
|------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1-1  | 产品名称       | 薄膜微带滤波器                                                      |
| 1-2  | 产品型号       | YTFBP14R25/R5-5SA                                            |
| 1-3  | 中心频率 $f_0$ | 14.25GHz                                                     |
| 1-4  | 1dB 带宽     | 14GHz~14.5GHz                                                |
| 1-5  | 插入损耗       | $\leq 2.5$ dB                                                |
| 1-6  | 带内波动       | $\leq 1$ dB                                                  |
| 1-7  | 带外抑制       | $\geq 30$ dB@10.7GHz-12.7GHz;<br>$\geq 30$ dB@15.7GHz-20GHz; |
| 1-8  | 带内驻波比      | $\leq 1.8$                                                   |
| 1-9  | 输入输出阻抗     | 50 欧姆                                                        |
| 1-10 | 输出安装方式     | 键合                                                           |

### 环境参数

|     |        |            |
|-----|--------|------------|
| 2-1 | 工作温度   | -45℃~+85℃  |
| 2-2 | 存储温度   | -55℃~+125℃ |
| 2-3 | 最高输入功率 | 35dBm      |

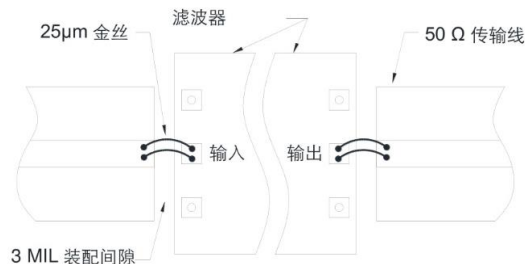
### 外形尺寸

|                                                                                                                                                                |      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 2-1                                                                                                                                                            | 外形尺寸 | 见下图（A、B 外形公差：±0.1mm）                            |
|  <p>0.26</p> <p>0.5</p> <p>0.2</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>■ IN/OUT □ GND</p> |      |                                                 |
| 2-2                                                                                                                                                            | 标识尺寸 | A: 5mm    B: 3.5mm （图中尺寸单位为 mm，A、B 外形公差：±0.1mm） |
| 2-3                                                                                                                                                            | 基板材料 | 陶瓷                                              |
| 2-4                                                                                                                                                            | 表面处理 | 镀金                                              |

### 版本状态

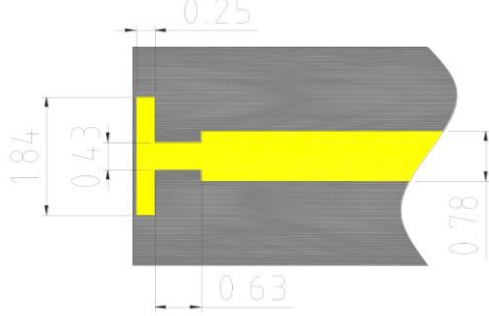
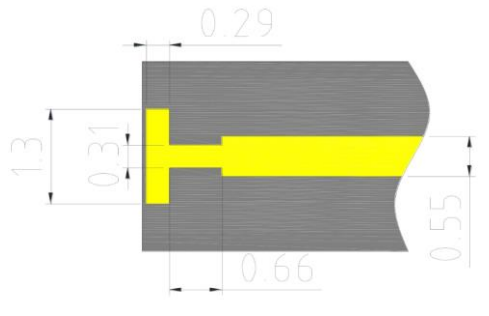
| 版本号 | 版本日期     | 文档状态 |
|-----|----------|------|
| V1  | 20250122 | ✓    |

### 建议装配图



### 注意事项

- 1、芯片建议分腔使用，两侧距离侧壁0.2mm左右，表面距离上盖板2mm左右，芯片端口可互换；
- 2、芯片应安装在可伐或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载片上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 3、芯片推荐使用低应力导电胶粘接；
- 4、电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型节尺寸如下：

| 电路板Rogers5880, 5mil厚                                                               | 电路板Rogers4350, 5mil厚                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 适用频率: DC-38GHz                                                                     | 适用频率: DC-32GHz                                                                      |
| 注: T型图形顶端基板白边50um; 频率10GHz以下无需匹配                                                   |                                                                                     |

### 仿真曲线:

